

证券代码：300054

证券简称：鼎龙股份

## 湖北鼎龙控股股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20230519

|               |  |
|---------------|--|
| 投资者关系活动类别     | <input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议<br><input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会<br><input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动<br><input type="checkbox"/> 现场参观<br><input type="checkbox"/> 其他  |
| 参与单位名称及人员姓名   | 博时基金：肖瑞瑾；广发资管：孙竹；财通基金：余江；银华基金：吴颖；砥俊资产：荣子龙；宇赢投资：王式平；开源证券：冯倩；招商证券：姚资宇、陈斯文、熊炜；国泰君安证券：沈唯；德邦证券：许蕾等 12 名投资者及证券人员   |
| 时间            | 2023 年 5 月 18 日下午 15:00-16:00  |
| 地点            | 公司 907 会议室，现场结合线上会议  |
| 上市公司接待人员姓名    | 董事长朱双全先生   |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>管理层介绍公司基本情况，并与投资者就公司半导体材料业务、打印复印通用耗材业务的经营及其他投资者关心的问题进行深入交流，主要交流内容如下：</p> <p><b>问 1：公司如何看待在上游供应链方面的布局？</b></p> <p><b>答：</b>公司坚持材料技术创新与上游原材料自主化培养同步，把供应链自主化摆在材料项目开发的关键位置。公司自主研制核心原材料，同时培养国内供应商，保障其他原材料的国产化供应。对于关键原材料的上几层供应商，公司也开展了一些合作。这些供应链方面的布局增强了公司材料产品的竞争能力：1、公司自主开发核心原材料，加深了对材料产品的理解，从上游进行材料开发，强化了材料项目的开发速度和开发效果。2、供应链自主化大大增强了公司材料产品的稳定性，一方面是品质的稳定性，另一方面是供应的稳定性。3、供应链自主化降低了公司材料产品的原料成本，提升了产品的盈利能力。</p> <p><b>问 2：公司技术人才团队的建设情况如何？</b></p> <p><b>答：</b>公司坚持材料技术创新与人才团队培养同步，建立了稳定的核心技术人才团队，培养并储备了一批既懂材料又懂应用的专业人才。1、从人才梯队结构来看，公司技术人才主要分为三代：第一代 60 后技术人才在早期为公司关键材料项目开发做出了重要贡献，第二代 80 后技术人才目前是公</p> |

司几类核心领域材料项目的牵头人，第三代 90 后技术人才是各创新材料项目的具体负责人，技术元老和新进技术人才之间融合得很好，形成了“老带新”的文化氛围和良好研发环境，既能根据公司多年来的研发经验把握整体开发进度，也能凸显新一代技术人才的研发能力。2、从技术领域来看，公司在物理化学、表面化学、有机化学、无机化学等多个技术领域都培养了专业的技术人才，具备跨领域跨团队共同解决材料研发问题的能力。3、从技术人才激励来看，公司给技术创新团队配备了创新的激励机制，把技术人才和新项目开发深度绑定，既加快了项目开发速度，同时也更好地留住人才，保持公司技术人才团队长期的稳定性。

### **问 3：公司如何看待近年和未来的研发投入？**

**答：**公司 2022 年研发投入 3.18 亿元，占总营收比例为 11.72%；2023 年度第一季度研发投入 8,691.87 万元，占总营收比例为 15.90%。公司从 2017 年开始加快了在半导体材料领域的研发布局，主要是为了抓住近几年半导体材料领域布局的黄金窗口期，实现细分领域的国产领先优势。公司作为进口替代类创新材料的平台型公司，全面、深入地在半导体 CMP 制程工艺材料、半导体显示材料、半导体先进封装材料等多个领域进行布局，因此近年来一直保持较高研发投入，以快速开发出产品并完成产业化布局。整体来看，公司今年或明年的研发投入水平可能已经到了峰值水平，主要原因为：1、前期布局的项目陆续步入成熟阶段，如 CMP 抛光垫业务已实现规模盈利，CMP 抛光液、清洗液及半导体显示材料 YPI、PSPI 规模化销售，相关产品的研发强度会较开发阶段有所下降。2、对于公司未来在一些关键大赛道进口替代类创新材料领域的探索布局，可能较之前更多地采取外部融资的方案，将公司的研发投入水平控制在一个合理的区间内。

### **问 4：公司在 CMP 抛光液方面有哪些竞争优势？**

**答：**公司已有数款 CMP 抛光液产品在客户端规模化销售，其他各制程 CMP 抛光液产品覆盖全国多家客户进入关键验证阶段。总体来看，公司 CMP 抛光液产品有多个优势：1、供应链优势，公司实现了 CMP 抛光液核心原材料研磨粒子的自主制备，研磨粒子对抛光液产品品质有较大影响，同时在抛光液的材料成本中占比较高，如果由国外材料厂商供应，供应价格、供应品质、重要型号是否供应均有不确定性。研磨粒子自制对公司抛光液产品的开发、品质稳定、自主可控、盈利能力等方面均带来了较大增益。2、平台化优势，公司作为创新材料的平台型企业，布局了集成电路制造 CMP 抛光环节的多款核心耗材，提供 CMP 制程工艺材料系统解决方案，这加深了公司对 CMP 抛光液产品应用的理解，加深了 CMP 抛光液、抛光垫等材料适配使用的理解，增强了公司抛光液产品的竞争力。

### **问 5：公司先进封装材料业务的布局情况如何？**

**答：**先进封装材料在国内的市场空间处于上升阶段，这是因为先进封装技术是集成电路制程进步、打破摩尔定律的关键技术，也是国内晶圆厂制程工艺技术进步的重要途径。公司选取了由国外材料厂商垄断、技术门槛高、同时与公司已有技术积累存在共性的三大类先进封装材料进行布局，目前都取得了预期进展。在先进封装材料的细分领域进行材料开发，不仅需要资本

|      |  |
|------|--|
|      | <p>和人才的投入，更需要对行业、用户、产品、供应链等方面的深度理解，这是公司二十多年在进口替代创新材料开发上不断积累带来的竞争优势。</p> <p><b>问 6：公司子公司旗捷科技芯片业务转型升级进展如何？</b></p> <p><b>答：</b>旗捷科技是一家集研发、生产与销售为一体的具有专业集成电路设计与应用能力的国家高新技术企业，在耗材芯片设计领域有丰富的经验，产品能力较强，经营业绩在同行业公司中也处于较好水平。从今年开始，旗捷科技在保持传统打印耗材芯片业务的同时，会重点聚焦于半导体领域，向工业级和车规级应用中的新产品方向进行深度转型。同时，公司通过实施员工持股计划，深度绑定旗捷科技核心技术骨干，并增强对新进人才的吸引力，促进旗捷科技在业务领域的升级转型。目前相关新产品都处在加速开发的阶段，后续会根据项目推进进度再行公布进展情况。</p> |
| 附件清单 | 无  |
| 日期   | 2023 年 5 月 18 日  |